

MultiPrep 200

铜粘结力促进剂

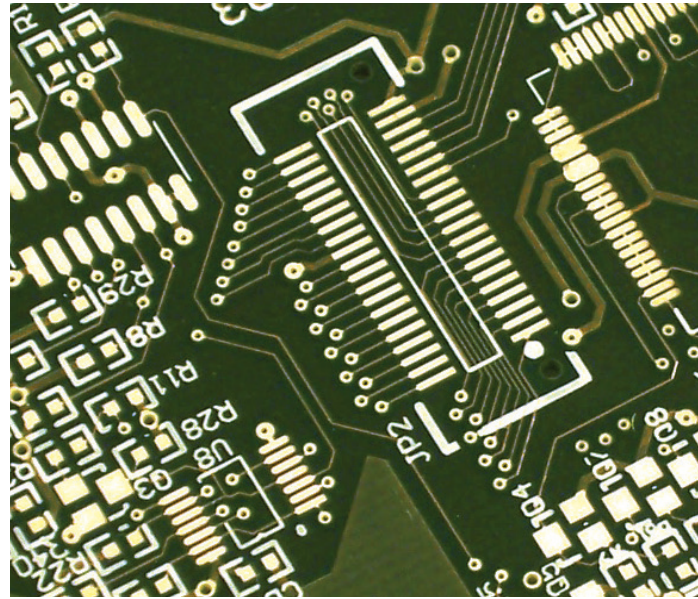
针对防焊、干膜及光阻 有高度结合力

MultiPrep 200铜面粗化工工艺创造了理想的铜表面用于防焊、干膜和液态光阻的附着力强化。**MultiPrep 200**消除了喷砂和刷磨的需求,提供均匀的铜面粗糙度及良好的结合力。

MultiPrep 200提供了优良的铜微糙表面,非常适合防焊前处理于微盲孔和细线路上,也可以在盲孔填孔和化学铜之间形成牢固、可靠的结合力。

MultiPrep 200药水提供了优化的铜表面粗糙度,非常适合防焊应用。此外,它与所有最终表面处理兼容,包括化学沉镍金、化学沉银、OSP和化学沉锡。

选择**MultiPrep 200**可获得铜与所有有机热填充物、涂层和薄膜的最佳的粘附力



KEY FEATURES

- 使用寿命长、易于控制,
- 建立高粘附力的表面微蚀形状
- 提供非常均一的外观



MacDermid Enthone

CIRCUITRY SOLUTIONS

MultiPrep 200

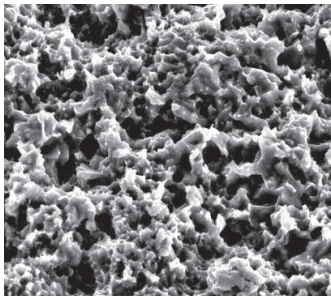
铜粘结力促进剂

定制的微粗糙工艺 提供卓越的油墨和光阻胶粘结力

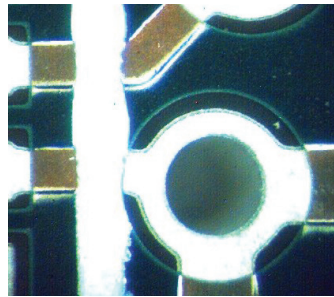
MultiPrep 200源于MacDermid Enthone数十年的铜蚀刻工艺经验,与许多其他工艺兼容。当您使用MultiPrep 200时,可以确保工艺持久地的可靠且,从而在供应链的各个层面得到认可。

MultiPrep 200提供的粗糙、微蚀的表面是复杂电路板上的微盲孔和细线路结构的理想选择,适合所有表面处理,并提供一致和清洁的表面。凭借我们享有盛誉的客户和技术服务以及全球OEM厂商的信赖,MacDermid Enthone是您可以信赖的湿工艺供应商,帮助您实现未来日益复杂的线路板设计。

MultiPrep 200

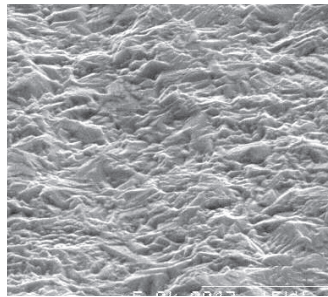


5K倍下的 SEM,
Zygo 结果: Ra=0.58 μ m
Rz=5.2 μ m

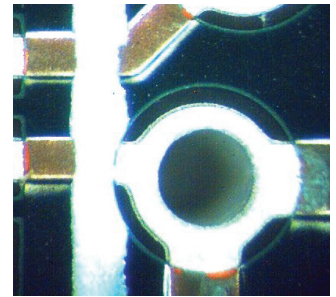


用于粘结防焊和光阻的均匀粗糙度(即使在沉锡后也能完美地通过胶带测试)

传统微蚀



5K 倍下的 SEM,
Zygo 结果: Ra=0.03 μ m,
Rz=0.36 μ m



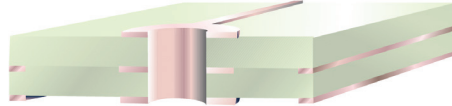
浸锡后,在胶带测试中防焊剥离

各种 MultiPrep 200 应用

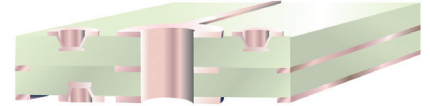
用于干膜和液态光阻的前处理清洁



防焊的微蚀



树脂堵塞孔的粗糙化



macdermidalpha.com
October, 2019

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

© 2019 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.

CIRCUITRY SOLUTIONS